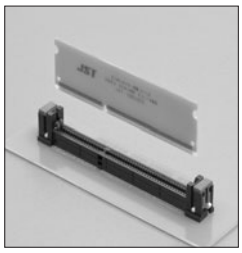
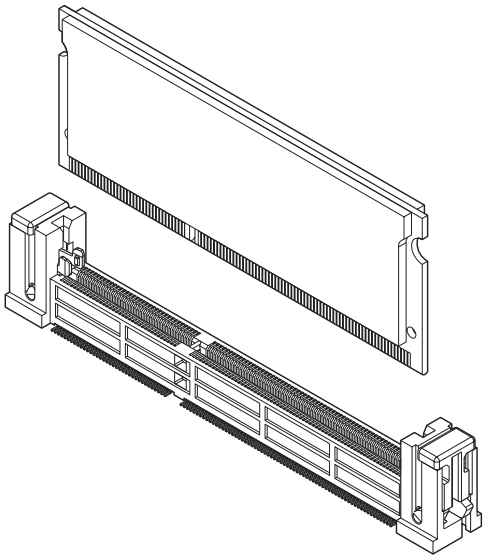


DIM CONNECTOR

0.6mmピッチ／DDR/DDR3 S.O.DIMM用ソケット



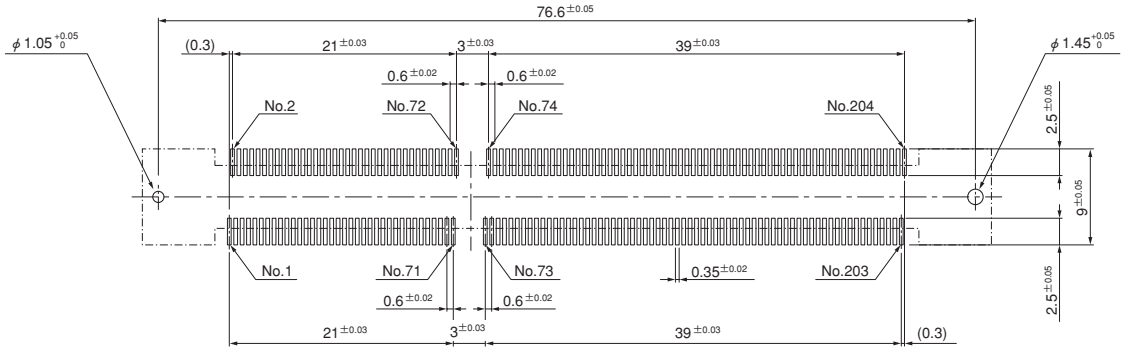
JEDEC(MO-268)に準拠したDDR3 S.O.DIMM 204極用ソケットです。
基板抜け防止機構を備え基板を保持します。また半嵌合防止対策として上方向、左右方向から目視で確認を行える機構を備えています。

- ●基板抜け防止機構
- ●半嵌合防止機構
- ●JEDEC (MO-268) 準拠

■一般仕様

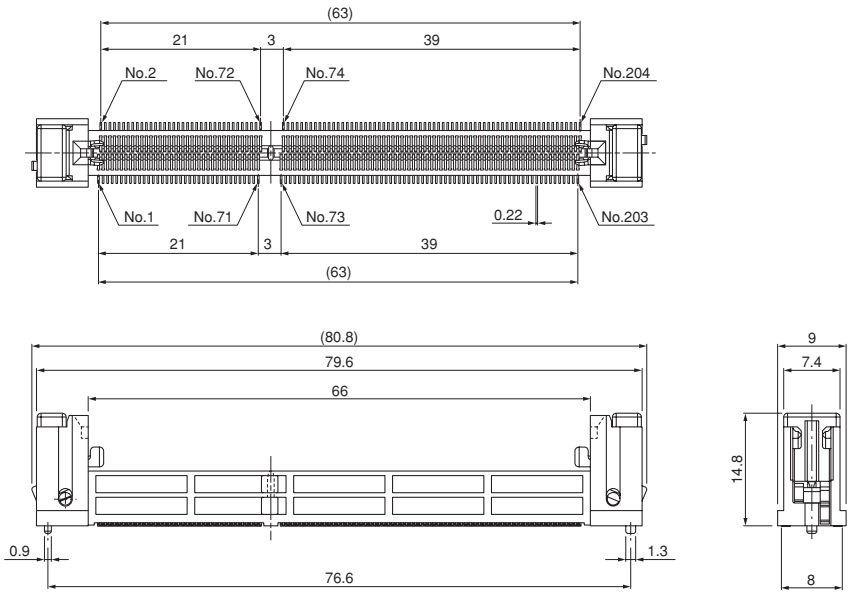
- ●定格電流：0.3A　AC・DC
- ●定格電圧：25V　AC・DC
- ●使用温度範囲：－25℃～＋85℃（通電時の温度上昇値を含む）
- ●絶縁抵抗：250MΩ以上
- ●耐電圧：AC 250V・1分間

※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。
※詳細は弊社までお問い合わせください。
※RoHS対応品を掲載しています。

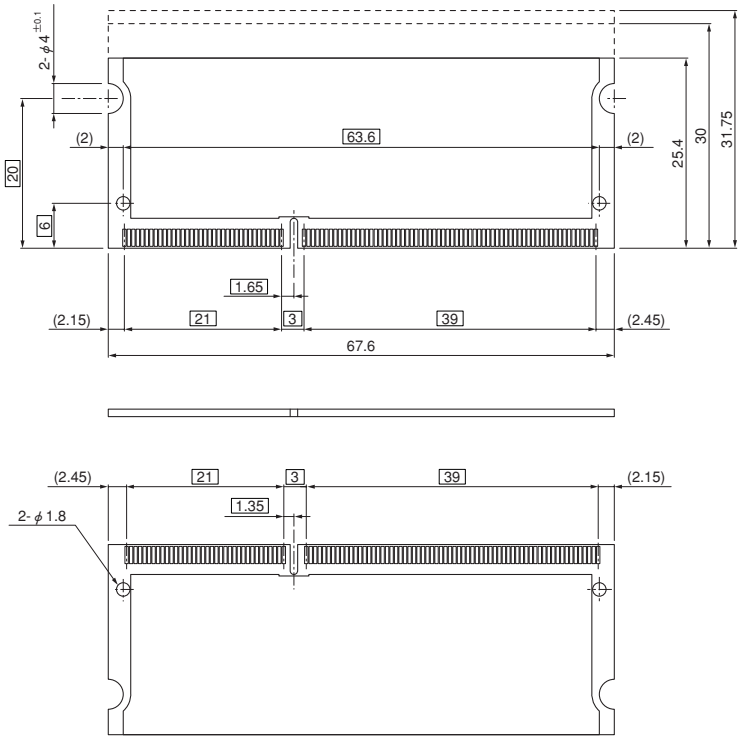


注1）上図はコネクタ装着側から見た図です。
2）基板のパターンピッチは全体にわたって公差±0.02で累積しないこと。上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

■コネクタ



形　番	材　質・表面処理	個数／箱
DIM-204SB-K2330-E	コンタクト：銅合金・ニッケル下地付部分金めっき ソケットハウジング：耐熱性樹脂・UL94V-0, 黒 回転ガイドハウジング：耐熱性樹脂・UL94V-0, ナチュラル 保持ガイドハウジング：耐熱性樹脂・UL94V-0, 青	210

●RoHS対応品

■適用モジュール基板